正本

檔　　號：
保存年限：

經濟部工業局　函

機關地址：106臺北市信義路三段41-3號
聯絡人：技士 許嫚珊
聯絡電話：02-27541255 分機2416
電子郵件：mssheu@moeaidb.gov.tw
傳真：02-27043762

241
新北市三重區重新路5段609巷6號3樓-3

受文者：台灣醫療暨生技器材工業同業公會

台灣醫療暨生技器材工業同業公會
收 107.08.08 文
檔號：107501

發文日期：中華民國107年8月6日
發文字號：工知字第10700784850號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：「2018台灣創新技術博覽會」將於107年9月27日至107年9月29日假台北世界貿易中心展覽一館盛大展出，敬邀貴單位組團參觀，請查照。

說明：

一、台灣創新技術博覽會(原名台北國際發明暨技術交易展)，今(108)年轉型為國際級展會並擴大展出規模，現場規劃「未來科技」、「創新發明」、「永續發展」三大主題專館，分別展示生技醫療、智慧製造及綠能科技等多項領域最新技術，另亦設立國際技術交易專區，邀請歐、美、日及東南亞等19國55家機構與企業來台參展，包括Amazon、Microsoft及Nissan Motor Co.等知名機構，以推動台灣成為國際研發成果流通樞紐平台。更多詳細資訊歡迎至本博覽會網頁，https://tie.twtm.com.tw/WebPage/index.aspx查詢。

二、敬邀貴單位邀集企業組團蒞臨參觀，本局將提供專人導覽服務，以促進專利技術媒合交易及國內產業發展。隨函檢附「台灣創新技術博覽會團體導覽報名表」1份。

三、若有垂詢，歡迎聯繫工研院技轉法律中心王丕華經理，

03-5919361，Joseph_Wang @itri.org.tw；李靜忠先生，03-5916318，LeeCJ@itri.org.tw。

正本：中華民國全國工業總會、臺灣機械工業同業公會、台灣區電機電子工業同業公會、台灣醫療暨生技器材工業同業公會、台灣電子設備協會、台灣智慧自動化與機械人協會、中華民國全國青年創業總會、中華民國創業投資商業同業公會、台灣科學工業園區科學工業同業公會、中華民國台灣半導體產業協會、中華民國資訊軟體協會、台北市電腦商業同業公會、台灣電路板協會、台北內湖科技園區發展協會

副本：經濟部工業局、財團法人工業技術研究院

局長 呂正華

依照分層負責規定授權單位主管決行

□打字發文
□存　卷

2018 年台灣創新技術博覽會團體導覽報名表

- 導覽日期：9 月 27 日(四)及 9 月 28 日(五)兩天
- 導覽時間：每場次約需 40 至 50 分鐘
- 參加場次：(請勾選)

  □ 9/27 15:00 □ 9/27 15:30 □ 9/27 16:00 □ 9/27 16:30 □ 9/28 10:00

  □ 9/28 11:00 □ 9/28 13:00 □ 9/28 14:00 □ 9/28 15:00 □ 9/28 16:00
- 集合地點：台北市信義路 5 段 5 號 台北世界貿易中心展覽一館
  靠近「台北君悅酒店」一側之入口大廳

- 報名單位：_____
- 聯絡人：_____ 職 稱：_____
- 手 機：_____ 人 數：_____ (15 至 20 人為宜)

序號	姓 名	手 機	序號	姓 名	手 機
1			11		
2			12		
3			13		
4			14		
5			15		
6			16		
7			17		
8			18		
9			19		
10			20		

➢ 報名窗口：

李靜忠 先生　LeeCJ@itri.org.tw，03-5916318，0910-293388

王丕華 經理　Joseph_Wang@itri.org.tw，03-5919361，0920-378263